

LPKF NEWSLETTER

+++ Mit dem 6-Monatsbericht 1999 +++

LPKF Laser & Electronics AG (WKN 645000) · Osteriede 7 · D-30827 Garbsen · Telefon +49(0) 51 31-70 95-0

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,



viele Gespräche mit Investoren in der jüngsten Zeit zeigten mir, dass das Interesse an LPKF sehr groß, dass aber das Wissen über unsere hochtechnologischen Produkte gering ist. Das soll anders werden: Unsere Aktionäre, unsere Teilhaber also, sollten unsere

Produkte und Strategien verstehen, um in ihrem positiven Engagement für LPKF bestätigt zu werden.

Jeder Elektronikentwickler muss heute seine Produktidee sehr schnell in die Produktrealität umsetzen. Design und elektronische Schaltung müssen schnellstens fertig werden. Als Marktführer für Rapid Prototyping in der Elektronikindustrie setzen wir den Standard. Dank einer erfolgreichen Marketingstrategie haben wir 1999 unseren Auftragseingang um 52 Prozent erhöht. Aber: Von den etwa 500.000 potentiellen Anwendern unserer Rapid-Prototyping-Systeme sind erst ca. 10.000 unsere Kunden. Hier setzen wir jetzt an!

Die neuen von LPKF entwickelten laserstrukturierten Leiterplattenverfahren setzen einen neuen technologischen Standard: 15µm-Strukturen sind erreichbar. Auch wenn die Umstellung auf ein völlig neues Technologiekonzept wie das der Schaltungsherstellung zeitaufwendig ist – viele Gespräche mit Elektronikkonzernen zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Wir haben immer wieder mit neuen Technologieprozessen Standards gesetzt und die Marktführerschaft übernommen. Das bleibt auch unser Ziel für die Zukunft. Der Börsengang hat uns ermöglicht, noch schneller die Umsetzung dieser Ziele durch Investitionen in Produktionsanlagen und globales Marketing zu erreichen. Mit starken Wachstumsraten bei Rapid-Prototyping und im Bereich Stencil-Laser als Basis stehen wir bei der lasergestützten Mikrostrukturierung von Schaltungen an der Schwelle einer neuen Technologie-Einführung. Deren Auswirkung auf den Elektronikproduktionsmarkt ist noch gar nicht absehbar.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie dazu Fragen haben.

Ich freue mich auf den weiteren Kontakt mit Ihnen.

Bernd Hildebrandt (Vorstandsvorsitzender)



Politische Prominenz im Hause LPKF: Bundesministerin Edelgard Bulmahn (rechts), Ministerpräsident Gerhard Glogowski (Mitte), und LPKF-Vorstand Jörg Kickelhain

3-D-MID Technik vorgestellt!

Ministerin Bulmahn: Gut investiert

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit der LPKF findet Beachtung auf höchster politischer Ebene. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Edelgard Bulmahn, stellte in der Garbsener Niederlassung am 19. Juli 1999 die Ergebnisse des Forschungsverbundvorhabens „Neue Material- und Fertigungstechnologien zur Integration mechanischer und elektrischer Funktionen in räumlichen Spritzgussteilen“ vor. Das Forschungsvorhaben mit einem Gesamtaufwand von 25 Millionen Mark, in das 17 Industriepartner - die LPKF dabei als anteilmäßig größtes Unternehmen - und vier Hochschulen eingebunden waren, wurde vom Bund mit 14 Millionen Mark gefördert. Gegenstand des dreieinhalb-jährigen Projektes war die Entwicklung einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Technologie, die es ermöglicht, Bauteile ohne Leiterplatten direkt an die Innenwand eines elektrischen Gerätes zu montieren - der sogenannten 3D-MID-Technik, die wir bereits im letzten LPKF-Newsletter vorgestellt haben. Anlässlich der

Feierstunde im Hause der LPKF AG in Garbsen, bei der neben Vertretern aus Industrie und Verwaltung auch Niedersachsens Ministerpräsident Gerhard Glogowski anwesend war, bezeichnete Edelgard Bulmahn die Fördergelder als „gut investiert“. Dieses Vorhaben, so Bulmahn weiter, sei ein „gutes Beispiel für den Erfolg, den eine enge und intensive Kooperation von industriellen und universitären Forschungsabteilungen aus verschiedenen Fachdisziplinen erzielen kann“ und ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Für die LPKF wies Forschungsvorstand Jörg Kickelhain darauf hin, daß die aktive Mitwirkung von Klein- und mittelständischen Unternehmen an derartigen Forschungs- und Entwicklungsprojekten „einen überaus wichtigen Mosaikstein bei so immens wichtigen Themen wie Minimierung von technologischem und finanziellem Entwicklungsrisiko“ darstelle ebenso wie beim Ausbau bestehender weltweiter Technologieführerschaft.



LPKF schafft neuen Markt für Fräsbohrplotter

Interview mit Bernd Hackmann, Produktions- und Vertriebsvorstand der LPKF

Mit der neuen Serie des Fräsbohrplottermodells ProtoMat will die LPKF einen neuen Markt erobern. Mit welcher Strategie?

Der Markt für Fräsbohrplotter ist im Grunde riesig und bei weitem nicht ausgeschöpft. Jeder Elektronikhersteller, der einen Prototypen entwickeln möchte und dafür die entsprechenden Leiterplatten benötigt, ist potentieller Kunde für den ProtoMaten. Das geht vom Ein-Mann-Ingenieur-Büro bis zum multinationalen Konzern. Zur Zeit ist es noch vielerorts üblich, das Prototyping einem Dienstleister zu überlassen. Mit dem neuen ProtoMaten kann diese Arbeit vor Ort in jedem Elektroniklabor durchgeführt werden. Das erspart Zeit, macht Korrekturen unkomplizierter und ist auf Dauer auch kostengünstiger.

Was unterscheidet die neue Serie vom Vormodell?

Zunächst einmal ist es uns gelungen, den ProtoMaten technisch zu verbessern, so daß sich beim Fräsen der Leiterplatten - auch mit den einfacheren Modellen - noch feinere Strukturen bis zu 0,1 mm erreichen lassen. Entscheidend für unser Ziel, neue Käufer-schichten zu erreichen, ist jedoch die hohe Bedienerfreundlichkeit und der niedrige Anschaffungspreis. Weil bei der Produktion des neuen Modell weniger Teile benötigt werden, konnten wir den Preis um 20 % drücken. Dazu kommt auch noch eine neue gefällige Gestaltung.

Das „freut“ sicher den Wettbewerb. Wie sieht der Markt aus?

Mit einem Marktanteil von 65 % waren wir schon beim Vormodell weltweit Marktführer. Mit der aktuellen Preissenkung wollen wir aber vor allem die Interessenten ansprechen, denen das Verfahren bisher insgesamt zu teuer erschien. Uns geht es also in erster Linie um die Erweiterung des Marktes - nicht um einen Verdrängungswettbewerb gegen unsere Mitbewerber.

Wo ist der konkrete Vorteil für den Kunden?

Bei der Entwicklung eines Prototypen spielen die Kosten eine immer wichtigere Rolle. Die bisherigen Preise für Fräsbohrplotter haben oft die Budgets gerade der kleineren Elektronikentwickler gesprengt und es nötig gemacht, die Leiterplattenherstellung an ein Fremdunternehmen abzugeben. Dank des niedrigeren Anschaffungspreises für den neuen ProtoMaten ändert sich das jetzt.

Wie kommt das neue Modell bei den Kunden an?

Wir haben einen sehr hohen Auftragseingang. Seit April ist die neue Serie am Markt, und die Nachfrage ist schon jetzt enorm. Durch die einfachere Konstruktion sind wir auch schneller lieferfähig.



Neue Wege in der SMD-Schablonen-Technik

Höchste Präzision durch StencilLaser/Polymer

Bei der Produktion von Lotpastenschablonen geht die LPKF wieder einmal neue Wege. Noch bis in die neunziger Jahre hinein war es allgemein üblicher Standard, die sogenannten SMD-Schablonen, mit denen das Lot auf Leiterplatten appliziert wird, mittels chemischer Ätztechnik herzustellen - einem Verfahren, das mit erheblicher Umweltbelastung verbunden ist. Zudem produzieren die chemischen „Schnitte“ der Ätztechnik keine senkrechten, sondern rundgeformte Schnittkanäle. Die Folge: Bei der Anwendung löst sich ein Teil der Lotpaste nicht vollständig von der Schablone und bleibt in den Schnittkanälen haften. Die Ausschußrate erhöht sich.

Bereits mit der innovativen Einführung lasergeschnittener SMD-Schablonen oder Stencils konnte LPKF zu Beginn des Jahrzehnts eine umweltfreundlichere und zuverlässigere Alternative zur Ätztechnik etablieren. Mit dem StencilLaser/Polymer präsentiert die Firma jetzt den neusten Stand der SMD-Schablonen-Technik. Statt den bisher ausschließlich üblichen Metallstencils bestehen die neuen lasergeschnittenen Schablonen aus hauchdünnem, durchsichtigen Kunststoff. Die Entwicklung eines speziellen Lasergerätes war dafür notwendig. Vorteil der neuen Technologie: Noch glattere Schnittkanäle verringern den Ausschuß abermals um den Faktor Zehn. Mit dem neuen Material lassen sich zudem noch feinere Strukturen erzielen und somit beim Verlöten höchste Ansprüche an die Präzision erfüllen.

Personalie

Wolfgang Greite, Leiter der Finanzabteilung und des Controllings der LPKF, erhielt die Unterschriftsvollmacht als Prokurist des Unternehmens.

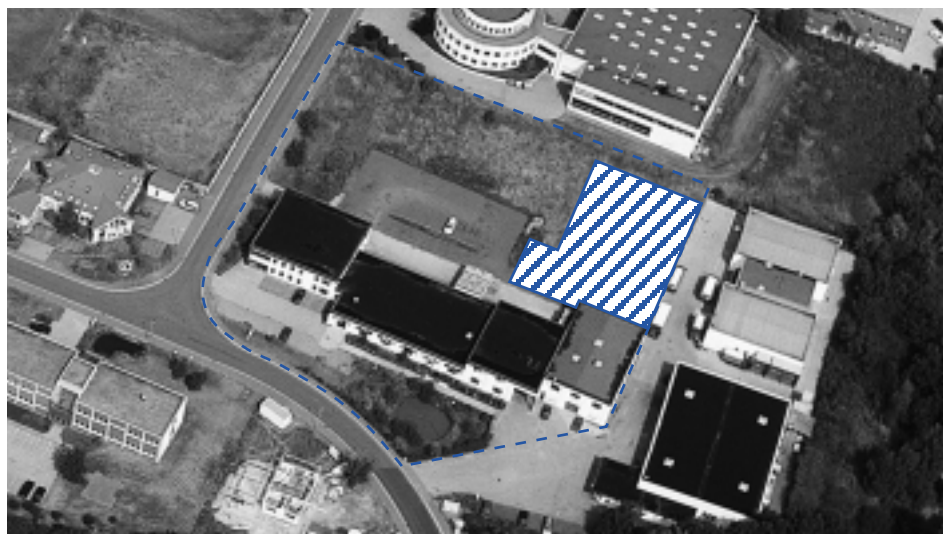
Die LPKF Motion & Control GmbH im thüringischen Suhl hat jetzt den Grundstein für eine neue Fertigung gelegt. Mit einem Investitionsaufwand von 2,5 Mio. Mark entsteht auf einem 1250 m² großen Gelände eine Produktionshalle für eine elektronische Fertigung. Ab April 2000 ist bei LPKF im Gewerbegebiet Friedberg Platz für 30-40 Mitarbeiter.

Neubau in Garbsen

LPKF schafft neue Produktions- und Fertigungskapazitäten

Die LPKF vergrößert sich. Noch in diesem Jahr soll mit den Bauarbeiten am dritten Bauabschnitt der Firmenniederlassung in Garbsen begonnen werden. Daß es auf der bisher zur Verfügung stehenden Fläche irgendwann zu eng werden könnte, war angesichts voller Auftragsbücher und zahlreicher neuer Projekte bereits vor zwei Jahren absehbar. Vorausschauend wurde deshalb 1997 ein angrenzendes Grundstück erworben und Ende vergangenen Jahres mit der Planung für den Neubau begonnen. Zur Zeit läuft noch die Genehmigungsphase. Der Baubeginn ist für September angesetzt. Ein Jahr später soll das Gebäude dann bezugsfertig sein.

Notwendig geworden war die Erweiterung, weil die derzeitigen Produktions- und Fertigungskapazitäten die steigende Nachfrage nach den LPKF-Produkten in Zukunft kaum befriedigen können. Der demnächst zur Verfügung stehende Platz wird u.a. benötigt für die Serienproduktion des MicrolinLasers, der 3D-MID-Technik sowie anderer Projekte, die sich zur Zeit noch in der Forschungs- und Entwicklungs- bzw. der Zertifikationsphase befinden.



Der geplante Erweiterungsbau wird auf der schraffierten Fläche entstehen

Durch den Neubau wird sich die bisherige Nutzfläche mit einem Zugewinn von 2200 Quadratmetern verdoppeln. Gut ein Drittel davon wird für Montage und Fertigung verwendet. Auf 1200 Quadratmetern entstehen neue Büros.

Die sind dringend nötig. Denn LPKF wird, wenn erst einmal die neuen Räume fertig sind, auch personell aufstocken. Schon jetzt würde man gerne noch mehr Personal beschäftigen. Vorstandsmitglied Bernd Hackmann: „Arbeit gibt es genug; nur mußte sie bisher auf immer engerem Raum ausgeübt werden!“

Äußerlich wird der dritte Bauabschnitt dem Kerngebäude von 1991 und dem Anbau von 1996 gleichen. Allerdings ist ein zusätzliches drittes Stockwerk vorgesehen, in dem dann u.a. der Vorstand residieren wird. „Das hat den Vorteil“, sagt Bernd Hackmann, „daß sich die Wege erheblich verkürzen. Wir können dann noch enger zusammenarbeiten.“

Auch an die Unternehmungskultur hat man bei der Planung gedacht. Ein schöner großer Seminarraum wird den repräsentativen Ansprüchen gerecht, wie sie der weltweite Markt, auf dem die LPKF mit ihren Produkten operiert, heutzutage stellt.

6-Monatsbericht 1999

Verehrte Aktionärinnen und verehrte Aktionäre,

LPKF ist auf einem guten Weg: die Ergebnisse nach dem Abschluß des zweiten Quartals zeigen, dass die Prognose, einen Umsatz von 40 Millionen DM für das ganze Jahr 1999 zu erreichen, realistisch ist. Die Umsatzrendite ist auf 12,2% gestiegen.

1. Konsolidierungskreis

Neben der Konzernmutter LPKF Laser & Electronics AG, Garbsen, sind folgende Tochterunternehmen in den Konzernabschluß einbezogen worden:

Name	Sitz	Beteiligungsquote %	Erwerb
Vollkonsolidierung			
ELASER Gesellschaft für Elektronik Laser und Automation GmbH	Suhl / Thüringen	100,0	1989
LPKF d.o.o.	Kranj / Slowenien	75,0	1995
Franklin Industries N.V.	Mechelen/Belgien	67,22	1995
LPKF Laser & Electronics Inc.	Portland / USA	60,0	1992
Equity-Konsolidierung			
LPKF Motion & Control GmbH	Suhl / Thüringen	50,0	1991
A-Laser Inc.	Beaverton / USA	20,0	1995

Die Umsätze dieser beiden Unternehmen betragen im ersten Halbjahr 1999:

	TDM
LPKF Motion & Control GmbH	1.590
A-Laser Inc.	686

2. Gewinn pro Aktie

Im Jahr nach der Börseneinführung beläuft sich der Gewinn pro Aktie bei einem Konzernergebnis von TDM 2.287 nach Steuern und ausgegebenen Aktien von 2.100.000 Stück auf DM 1,09 für das erste Halbjahr.

3. Belegschaft

Die Mitarbeiterzahl setzt sich zum 30. Juni wie folgt zusammen:

	30.06.99	1998
Produktion	27	22
Vertrieb	20	18
Forschung & Entwicklung	22	22
Technik und Verwaltung	40	30
	109	92

4. Segmentberichterstattung

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

a) Produktgruppen (01.01. – 30.06.1999)

	01.01. – 30.06.99		1998
	TDM	TDM	TDM
Lasersysteme	7.765	15.594	15.594
Rapid Prototyping	8.384	13.451	13.451
Schablonen	1.065	2.101	2.101
Sonstiges	1.525	786	786
	18.739	31.932	31.932

b) Regionen (01.01. – 30.06.1999)

	01.01. – 30.06.99		1998
	TDM	TDM	TDM
Deutschland	3.452	8.394	8.394
Übriges Europa	5.272	8.307	8.307
Nord-Amerika	6.204	7.590	7.590
Süd-Amerika	209	225	225
Asien	3.495	7.334	7.334
Übrige	106	82	82
	18.739	31.932	31.932

Konsolidierte Bilanz (TDM)

Aktiva	30.06.1999	31.12.1998	Passiva	30.06.1999	31.12.1998
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Immaterielle Anlagen	1.880	1.677	Gezeichnetes Kapital	10.500	10.500
Sachanlagen	8.055	7.978	Kapitalrücklage	17.100	17.100
Finanzanlagen	1.501	1.473	Gewinnvortrag	4.252	1.381
Total Anlagevermögen	11.436	11.128	Konzernergebnis	2.287	2.871
Umlaufvermögen			Ausgleichsposten aus der Währungsumrechng.	-15	-159
Vorräte	11.052	8.465	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	2.015	902
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.879	4.548		36.139	32.595
Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	4	514	Rückstellungen		
Sonstige Vermögensgegenstände	2.757	1.524	Rückstellungen für Pensionen	322	324
Wertpapiere			Steuerrückstellungen	626	79
Flüssige Mittel	14.202	17.158	Sonstige Rückstellungen	1.024	1.153
Rechnungsabgrenzungsposten	150	144		1.972	1.556
Steuerabgrenzungsbetrag	5	85	Verbindlichkeiten		
Total Umlaufvermögen	33.433	32.438	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.692	6.448
Total Aktiva	44.485	43.566	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	175	446
			Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	1.497	1.536
			Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	186	185
			Sonstige Verbindlichkeiten	1.607	544
				6.157	9.159
			Rechnungsabgrenzungsposten	49	91
			Steuerabgrenzungsbetrag	149	165
			Total Passiva	44.485	43.566

Konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (01.01. – 30.06.99)

	TDM
Umsatzerlöse	18.739
Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	370
Sonstige betriebliche Erträge	1.666
	20.775
Materialaufwand	4.724
Personalaufwand	5.098
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.152
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.958
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen	47
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	253
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.966
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.140
Konzernjahresüberschuß	2.826
Ausgleichsposten für andere Gesellschafter	539
Konzernergebnis	2.287

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

- Übernahme der Restanteile von LPKF Franklin, Belgien
- Gründung LPKF Frankreich



Konsolidierte Mittelflußrechnung (01.01. – 30.06.99)

	TDM
Laufende Geschäftstätigkeit	
Jahresüberschuß	2.826
Abschreibungen auf das Anlagevermögen	1.152
Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	-48
Veränderungen der Vorräte und Forderungen	-3.722
Veränderungen des sonstigen Fremdkapitals	1.274
Mittelzufluß aus laufender Geschäftstätigkeit	1.483
Investitionstätigkeit	
Anlageinvestitionen	-1.411
Anzahlungen auf Beteiligungen	0
Erlöse aus Anlageabgängen	27
Mittelabfluß aus Investitionstätigkeit	-1.384
Finanzierungstätigkeit	
Zahlung Dividende	0
Einzahlung von Gesellschaftern	0
Anteile anderer Gesellschafter	574
Veränderung langfristiger Bankdarlehen	-3.916
Mittelab-/zufluß aus der Finanzierungstätigkeit	3.342
Veränderung des Finanzmittelbestandes	
Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbedarfs	-65
Veränderungen des Finanzmittelbedarfs	3.244
Finanzmittelbestand am 01.01.	16.788
Finanzmittelbestand am 30.06.	13.479
Zusammensetzung des Finanzmittelbestandes	
Liquide Mittel	14.202
Kontokorrentverbindlichkeiten	723
Finanzmittelbestand	14.926